公司代码:603005　　公司简称:晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为:以公司目前总股本扣除公司回购产生的库存股后作为基数(最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准,在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的,每股分配将按比例不变的原则相应调整),向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),共计人民币78,170,880.72元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.15%。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	–	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	吉冰沁
联系地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电话	0512-67730001	0512-67730001
传真	0512-67730808	0512-67730808
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

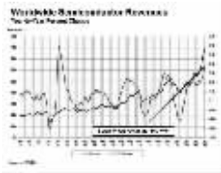
2、报告期公司主要业务简介

公司属于半导体集成电路(IC)产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支,各分支包含的种类繁多且应用广泛,在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。

(一)半导体整体市场情况

根据美国半导体行业协会(SIA)发布数据,2025年全年全球半导体行业销售额首次突破7,000亿美元大关,达7,917亿美元,同比增长25.6%。预计2026年仍将实现加速增长至9,754亿美元,逼近万亿美元。AI时代浪潮下,以存储、光模块等为代表的AI基础设施硬件与汽车智能化背景下的汽车电子为核心增长引擎。

图一 2025年全球半导体行业销售额



数据来源:全球半导体贸易统计协会(WSTS)

从地区来看,2025年美洲和亚太地区引领产业增长,增长率分别为30.5%和45.0%。相比之下,欧洲呈现温和增长,增长率为6.3%,日本销售额有所下降,下降幅度为4.7%。

从细分市场来看,2025年几个半导体产品细分市场表现突出,其中逻辑产品销售额增长39.9%,达到3,019亿美元,成为销售额最大的产品类别。存储器产品销售额位居第二,2025年增长34.8%,达到2,231亿美元,这两大市场均受到AI、云基础设施、先进消费电子产品等领域持续需求的推动。

聚焦到封测产业发展情况,根据Yole的报告,先进封装将扮演日益重要的角色,预计全球先进封装2024–2030年市场规模预计由约460亿美元扩容至约800亿美元。其中,根据Yole的预计2025年全球2.5D、3.0D先进封装市场规模约为160亿美元。在这一过程中,受益于3D堆叠技术利用TSV(硅通孔)实现了最短的垂直互连距离,消除了Chiplet之间的横向通信延迟(Inter-chiplet latency)问题,驱动2.5D/3D封装将以远高于行业均值的复合增速快速放量,成为AI服务器、HBM及高性能计算(HPC)需求外溢的主要载体,全球先进封装已演变为承接摩尔定律与AI算力扩张的核心增量环节。

图二 2025年全球2.5D、3.0D先进封装市场收入

数据来源:YOLE

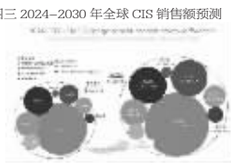
(二)公司所处细分市场情况

1、传感器市场

公司专注于集成电路先进封装技术,拥有领先的硅通孔(TSV)、晶圆级、Fanout、系统级等多样化的封装技术,具备为客户构建完整的传感器芯片的异质集成能力,聚焦于以影像传感芯片为代表的传感器领域,封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等,相关产品广泛应用在智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器人、AI眼镜等市场领域。

根据研究机构YOLE在2025年发布的报告,从全球CIS出货量来看,2025年前三季度出货量为63.5亿颗,同比去年增长4%,预计2025年全年出货量将达89亿颗;从全球CIS市场收入来看,2024年全年收入达232亿美元。相关机构预计至2030年,全球CIS市场将保持平稳增长到301亿美元,但产品结构将发生较大变化,受益于汽车智能化趋势推动,汽车与工业视觉将成为增量主力,手机占比继续下降但仍是最大单品市场。

图三 2024–2030年全球CIS销售额预测



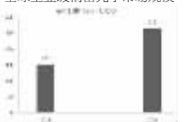
数据来源:YOLE

2、光学器件市场

精密光学产品作为视觉成像系统或其核心部件发展迅速,其应用范围包括照相机、望远镜、显微镜等传统光学产品,近年来消费级精密光学作为智能手机、安防监控摄像头、车载摄像头等产品的核心部件,成为影响终端产品应用效果的重要因素;

与此同时随着工业测量、激光雷达、航空航天、生命科学、半导体、AR/VR检测等新兴领域的市场需求增长,工业级精密光学将迎来快速发展趋势,产业发展空间广阔。根据Global Industry Analysts数据,2024年全球精密光学的市场规模为304.0亿美元,预计2030年市场规模将达到525.0亿美元,对应2025–2030年CAGR为9.5%。

图四 全球工业级精密光学市场规模



数据来源:Global Industry Analysts

(一)主营业务

公司主要专注于传感器领域的封装测试业务,拥有多样化的先进封装技术,同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线,涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力,为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等,该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、机器人、AI眼镜、全景式相机等电子领域。同时,公司通过并购及业务技术整合,有效拓展微型光学器件的设计、研发与制造业务,并拥有一站式的光学器件设计与研发,完整的晶圆级光学微型器件核心制造能力,相关产品广泛应用在半导体设备、工业智能、车用智能投射等应用领域。

(二)经营模式

公司所处封装行业的经营模式主要分为两大类:一类是IDM模式,由IDM公司设立的全资或控股的封装厂,作为集团的一个生产环节,实行内部结算,不独立对外经营;另一类是专业代工模式,专业的封测企业独立对外经营,接受芯片设计或制造企业的订单,为其提供专业的封装服务,按封装量收取封装加工费。

公司为专业的封测服务提供商,经营模式为客户提供晶圆或芯片委托封装,公司根据客户订单制定月度生产任务与计划,待客户将需加工的晶圆发到公司后,公司自行采购原辅材料,由生产部门按照技术标准组织芯片封装与测试,封装完成及检验后再将芯片交还给客户,并向客户收取封装测试加工费。对于公司拓展的微型光学器件业务,公司根据客户的需求,进行光学器件的设计、研发,自行采购原辅材料,由生产部门按照设计参数与技术工艺标准进行生产制造,完工检验后将光学器件出售给客户,并向客户收取产品销售货款,公司与客户签署产品销售合同,约定产品采购数量、销售单价等事项。

销售方面,公司主要向芯片设计公司提供封装、测试和封测方案设计服务。芯片设计公司主要负责芯片电路功能设计与芯片产品的销售。芯片设计公司完成芯片设计,交给晶圆代工厂(Foundry)制造晶圆芯片,晶圆芯片完工后交付公司,由公司组织进行芯片封装、测试,公司与客户建立合作关系时,签署委托加工框架合同,客户定期发送加工订单确定加工数量、价格等事项。对于微型光学器件业务,公司根据客户的需求进行光学器件产品的设计、开发与生产,并向客户进行产品销售出货,公司与客户建立合作关系时,双方签署采购订单或合同,约定产品的采购数量、价格等。

采购方面,公司采购部直接向国内外供应商采购生产所需原辅材料。具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划,并制定原材料采购计划与清单,采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购,并跟催物流交货进度,材料到货后由质保部门负责检验,检验合格后仓库入库并由生产领用。公司与供应商建立了长期的合作关系,根据市场状况决定交易价格。

(三)公司所处产业链环节

公司封装业务所处产业链主要包括芯片设计、晶圆制造与封装测试几个产业环节,同时还涉及相关材料与设备等支撑产业环节。产业以芯片设计为主导,由芯片设计公司设计出集成电路,然后委托芯片制造厂生产晶圆,再委托封装厂进行芯片的封装、测试,最后销售给电子整机产品生产企业。对本公司而言,芯片设计企业委托公司进行封装加工,是公司的客户;材料等支撑企业为公司提供生产所需的原材料,是公司的供应商。

公司光学器件业务上游主要为光学原材料制造,参与者主要为生产光学玻璃的材料企业;中游为光学元件及其组件,是将光学玻璃通过精密加工,生产成光学元件及镜头等产品的环节;下游主要包括消费电子、仪器仪表、半导体制造、车载镜头、激光器、光通信等行业。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,172,547,549.51	4,748,335,144.33	8.93	4,824,122,558.00
归属于上市公司股东的净资产	4,608,200,142.42	4,275,578,652.58	7.78	4,088,742,566.33
营业收入	1,473,887,081.78	1,129,957,381.01	30.44	913,288,878.20
利润总额	418,264,949.58	278,559,829.69	50.15	160,819,750.87
归属于上市公司股东的净利润	369,617,694.92	252,758,312.83	46.23	150,096,690.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,237,804.93	216,521,823.84	51.60	115,945,279.82
经营活动产生的现金流量净额	483,929,390.85	355,479,310.56	36.13	305,581,902.42
加权平均净资产收益率(%)	8.33	6.06	增加2.28个百分点	3.72
基本每股收益(元/股)	0.57	0.39	46.15	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.39	46.15	0.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	290,803,813.80	376,415,388.74	398,739,144.27	407,928,734.97
归属于上市公司股东的净利润	65,356,761.36	99,506,641.51	108,887,262.24	95,867,029.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,998,864.08	96,019,616.51	94,851,706.85	82,367,617.49
经营活动产生的现金流量净额	61,582,283.99	97,398,818.21	150,728,495.02	174,219,793.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							143,132
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中新苏州工业园区创业投资有限公司	0	102,849,766	15.77		无		国有法人
香港中央结算有限公司	1,222,774	7,029,358	1.08		未知		未知
招商银行股份有限公司–南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	605,025	5,993,836	0.92		未知		未知
丁贤平	1,173,700	4,168,616	0.64		未知		未知
国泰海通证券股份有限公司–国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	-3,262,143	4,061,059	0.62		未知		未知
招商银行股份有限公司–华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	889,700	3,779,804	0.58		未知		未知
瑞众人寿保险有限责任公司–自有资金	3,027,400	3,027,400	0.46		未知		未知
中国工商银行股份有限公司–广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	472,900	2,711,900	0.42		未知		未知
上海国盛资本管理有限公司–上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,656,061	0.41		未知		未知
中国银行股份有限公司–中信保诚新兴产业混合型证券投资基金	2,359,376	2,359,376	0.36		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务,聚焦于传感器领域,封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片、射频芯片等,相关产品广泛应用在汽车电子、AIOT(安防监控数码等)、智能手机、身份识别等市场领域。

2025年在数据、算力、存储、智能传感等市场需求驱动下,全球半导体产业规模恢复增长,作为半导体行业的重要组成部分,以图像传感器(CIS)为代表的智能传感器市场,整体市场也保持增长势头。在此背景下,公司2025年通过技术持续创新、不断拓展新的应用市场,整体业务恢复快速增长趋势,尤其是随着汽车智能化的快速推进,公司在车用CIS领域的技术领先优势不断提升、业务规模快速增长,带动公司业务规模与盈利能力实现快速增长。报告期内,公司实现销售收入147,388.71万元,同比增加30.44%,实现营业利润41,847.48万元,同比增加45.16%,实现归属于上市公司股东的净利润36,961.77万元,同比增加46.23%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2026-002

苏州晶方半导体科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2026年2月14日以通讯和邮件方式发出通知,于2026年2月27日在公司会议室召开。会议应到董事7人,实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决,通过了相关议案,形成决议如下:

(一)会议审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

(三)会议审议通过了《关于公司2025年度独立董事工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。《公司2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(四)会议审议通过了《关于公司2025年度审计委员会工作报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2025年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(五)会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(六)会议审议通过了《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。《公司2025年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(七)会议审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(八)会议审议通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。《公司2025年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(九)会议审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(十)会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。同意2025年度公司的利润分配方案:2025年末公司总股本为652,171,706股,其中以集中竞价回购产生的库存股747,700股,2025年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本651,424,006股为基数(最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准,在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的,每股分配将按比例不变的原则相应调整),向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),共计人民币78,170,880.72元。本议案尚需提交股东会审议。

(十一)会议审议通过了《关于公司2025年关联交易执行情况的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决,本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。《关于公司2025年关联交易执行情况的议案》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(十二)会议审议了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。关联董事王蔚先生、Vage Oganesian先生、刘海燕女士、王正根先生、王义乾先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(十三)会议审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事王蔚先生、Vage Oganesian先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十四)会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。《公司续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(十五)会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

(十六)会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,《关于2025年度计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

(十七)会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。《公司召开2025年度股东会的通知》详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2026-006

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更加真实、准确地反映苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下:

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据识别和测试的结果,计提了相关 资产的减值准备。公司2025年对各项资产计提信用与减值准备合计为:31,337,260.85元,其中计提应收账款坏账准备885,316.01元,其他应收款坏账准备-23,367.48元,存货减值准备30,083,347.81元,商誉减值准备391,964.51元。

二、资产减值准备计提的具体情况说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;对于其他应收款,根据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之 间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司根据存货可变现净值、存货账面成本实际情况,对存货成本高于可变现净值存货的,相应计提存货跌价准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提资产及信用减值准备合计31,337,260.85元,使得公司2025年度合并利润总额减少31,337,260.85元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会影响公司正常经营。

四、履行的审批程序

1、董事会表决情况

公司于2026年2月27日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

2、审计委员会表决情况

公司于2026年2月24日召开了第六届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,认为公司本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定,并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会影响公司正常经营。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2026-004

苏州晶方半导体科技股份有限公司关于2025年日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易情况已经公司第六届董事会第二次会议、第六届审计委员会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第六届董事会第二次会议于2026年2月27日审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》,关联董事已回避表决,上述议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2、审计委员会意见

公司第六届审计委员会第四次会议于2026年2月24日审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》,认为公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动,相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

3、独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2026年2月24日审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况的议案》,认为公司2025年发生的上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

(二)公司2025年日常关联交易执行情况

1、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额	差异原因
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	300,000.00	64,670.96	需支付的技术使用费较少
项目开发费用等	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	127,963,539.82	125,400,847.78	项目开发及材料供应增加
设备开发与销售	苏州晶拓精密科技有限公司	20,000,000.00	17,005,140.71	设备开发与购置费用有所减少

2、出售商品、提供劳务发生的关联交易

单位:人民币元

关联交易类别	关联方	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额	差异原因
封装服务费	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	20,000,000.00	12,681,149.59	封装业务减少
租赁费及物业费		1,445,473.44	1,371,576.78	
租赁费及物业费	苏州晶拓精密科技有限公司	54,495.41	54,495.41	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

创始人:A.Badih

注册地:3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor, Tel Aviv 6702301 Israel

主营业务:目前无实际经营业务

2、苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:王蔚

注册地:江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋120室

注册资本:1000万元整

经营范围:半导体分立器件制造;电子元器件制造;集成电路设计;集成电路芯片设计设计及服务;集成电路芯片及产品制造;光电子器件制造;工程和技术研究和实验发展;技术推广服务。知识产权服务(专利代理服务除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;电力电子元器件制造;其他电子器件制造;照明器具制造;创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3、苏州晶拓精密科技有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:王蔚

注册地:江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋121室

注册资本:1000万元整

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;货物进出口;工程和技术研究和试验发展;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;光电子器件制造;光电子器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子专用设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)与公司的关联关系

公司名称	与公司的关联关系
Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	公司监事担任其CEO
苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	公司参股,持有其30%的股份,公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人
苏州晶拓精密科技有限公司	公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人

(三)前期同类关联交易未发生违约情形,前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

(一)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格。

(二)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

(三)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

(四)交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

(五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司及全体股东的利益。

(二)交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2026-003

苏州晶方半导体科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 分配比例及送转比例:每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股利润分配不变,相应调整分配总额。

● 本年度现金分红比例低于30%,主要因为行业特征及公司发展处于成长阶段,研发投入、营运资金投入等所需资金较大。

一、利润分配和送转预案内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,母公司可供分配利润为人民币1,993,001,628.08元。

经董事会决议,公司2025年度利润分配预案为:2025年末公司总股本为652,171,706股,其中以集中竞价回购产生的库存股747,700股,2025年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本651,424,006股为基数(最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准,在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的,每股分配将按比例不变的原则相应调整),向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),共计人民币78,170,880.72元。

二、本年度利润分配预案与公司业绩成长性的匹配性说明

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务,聚焦全球传感器市场应用领域,为全球传感器领域先进封装技术的引领者与市场龙头,封装的产品主要包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等,相关产品广泛应用于智能手机、安防监控、汽车电子等市场领域。2025年随着国际贸易逆全球化、地缘政治博弈的持续演绎加剧,全球经济发展在困境中弱复苏、仍处于低增长状态。半导体行业作为信息社会的战略支柱产业,国际间的博弈激烈程度持续激化,产业链重构趋势加剧演进,尤其在人工智能、生成式AI技术为代表的科技创新领域,全球竞争与产业制衡呈现白热化趋势,在此背景下,数据、算力、存储、智能传感等应用市场发展趋势强劲,驱动全球半导体产业规模恢复增长。

面对2025年半导体行业及公司所处细分市场的发展趋势,公司持续专注集成电路先进封装技术的开发与服务,通过技术持续创新进一步巩固提升领先优势,有效拓展新的应用市场;积极发展微型光学器件业务,有效提升量产与商业应用规模;持续推进国际先进技术协同整合与产业链拓展延伸,并根据新的产业重构趋势进行全球化的生产、市场与投融资布局。得益于这些举措,公司2025年封装测试业务显著增长,尤其在汽车电子应用领域的领先优势不断提升。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告(容诚审字[2026]215Z0049号),2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润36,961.77万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,823.78万元,较2024年同比分别增长了46.23%、51.60%。公司2025年度利润分配预案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币369,617,694.92元,2025年年度分红拟分配的现金红利总额为78,170,880.72元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为21.15%,主要基于以下因素:

(一)公司所处行业情况及特点

公司属于集成电路产业中的封装测试行业,所处行业具有显著的技术密集、资本密集和人才密集的行业特征。生产所需的机器设备等资本投入规模较大,人力与智力投入大,产业技术创新日新月异,市场需求变化步伐快,需要企业专注主业,通过持续技术创新,加大资本投入、构建核心人才队伍来应对市场与产业的变化与革新。

(二)公司发展阶段

公司处于成长发展阶段,专注于集成电路先进封装技术的开发与服务,聚焦全球传感器市场应用领域,为全球传感器领域先进封装技术的引领者与市场龙头。封装的产品主要包括影像传感芯片、生物身份识别芯片、MEMS芯片等,相关产品广泛应用于智能手机、安防监控、汽车电子等应用领域。

2025年随着国际贸易逆全球化、地缘政治博弈的持续演绎加剧,全球经济发展在困境中弱复苏、仍处于低增长状态。半导体行业作为信息社会的战略支柱产业,国际间的博弈激烈程度持续激化,产业链重构趋势加剧演进,尤其在人工智能、生成式AI技术为代表的科技创新领域,全球竞争与产业制衡呈现白热化趋势。在此背景下,公司2025年业务规模与盈利能力虽呈现快速增长趋势,尤其在汽车电子应用领域的领先优势不断提升。但为积极应对复杂国际贸易环境、全球产业链重构趋势等相关影响,公司仍需进一步创新提升先进封装技术核心竞争能力,聚焦市场与产品发展需求,不断持续技术服务能力;持续推进产业链延伸拓展与新技术的商业化应用,拓展培育新的业务机会与增长驱动;积极推进海外生产基地的筹划与建设,以更好贴近海外客户需求,推进工艺创新与项目开发,积极融入全球化产业链重构新格局。

(三)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额(元)	78,170,880.72	54,719,616.50	30,020,300.40
回购注销股份总额(元)	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润(元)	369,617,694.92	252,758,312.83	150,096,690.43
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,993,001,628.08		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	162,910,797.62		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	–		
最近三个会计年度平均净利润(元)	257,490,566.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	162,910,797.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	63.27%		
现金分红比例(E)是否低